

# Fiche de procédure

Informations de base					
DEA - Procédure d'acte délégué	<a href="#">2018/2947(DEA)</a>	Procédure terminée - acte délégué entre en vigueur			
Exemption relative au plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semi-conducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée					
Complétant <a href="#">2008/0240(COD)</a>					
Sujet					
3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique					
3.70.13 Substances dangereuses, déchets toxiques et radioactifs (stockage, transport)					
Portail de documentation					
Document de base non législatif		<a href="#">C(2018)07499</a>	16/11/2018	EC	